

高電流密度対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤

トップルチナHV

Additives for Acid Copper Plating to Via-filling under High Current Density










TOP LUCINA HV

- ▶ 優れたビアフィリング性能を発揮
- ▶ 幅広い電流密度(1.0~10A/dm²)に対応可能
- ▶ 全ての添加剤成分の定量分析が可能
- ▶ 2液構成のため、浴管理が簡便

- Can show great via-filling performance
- Applicable to wide current density (1.0 to 10A/dm²)
- Quantitative analysis is possible for all additives
- Use two components, easy bath control

幅広い電流密度で優れたビアフィリング性能を発揮

Can show great via-filling performance in wide current density areas

		電流密度 Current density		
		6A/dm ²	8A/dm ²	10A/dm ²
めっき膜厚 Film thickness	10μm	 ビアフィリング達成 Great via-filling performances		
	12μm		 ビアフィリング達成 Great via-filling performances	
	14μm			 ビアフィリング達成 Great via-filling performances

硫酸銅五水和物 220g/L, 硫酸 80g/L 塩化物イオン 50mg/L
穴径 75μm, ビア深さ 50μm

CuSO₄·5H₂O 220g/L, H₂SO₄ 80g/L, Cl⁻ 50mg/L
Via hole diameter 75μm, Via hole depth 50μm